

# 第26期 中間(第2四半期)報告書

平成22年4月1日から平成22年9月30日まで

東京エレクトロン デバイス株式会社

証券コード 2760

## 株主の皆様へ

株主の皆様には、平素から格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 当社第26期中間報告書（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）として事業の概況等をご報告いたします。

代表取締役会長 砂川 俊昭（左）

代表取締役社長 栗木 康幸（右）



## 当中間期（第2四半期）の経営成績

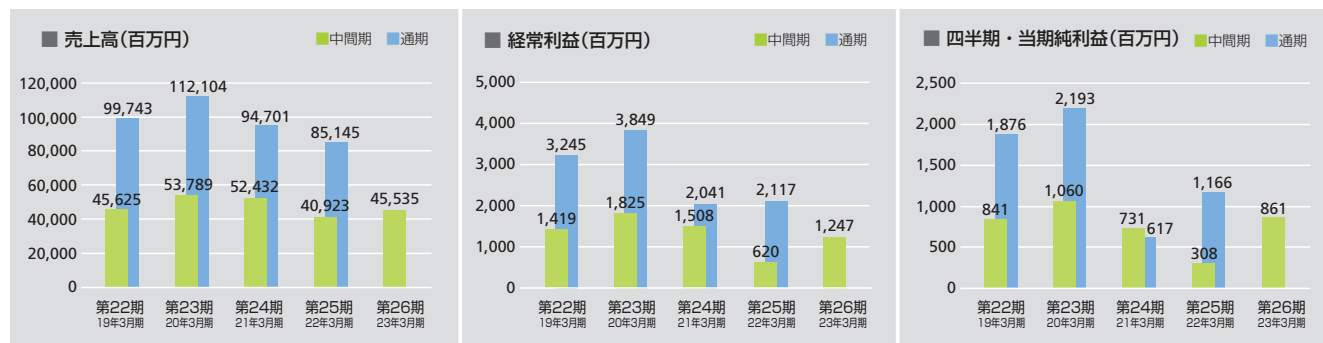
当中間期におけるわが国経済は、デフレ状態が依然続いており、景気は回復基調にあるものの、そのペースが鈍化するなど、企業の業績見通し等に慎重な姿勢が見受けられる中、推移してまいりました。

当社グループが参画しているエレクトロニクス業界においては、スマートフォン市場の拡大や産業機器・自動車関連の半導体製品に対する需要回復等、堅調に推移いたしました。一方、国内企業におけるIT投資に関しては更新投資等に限られるものが多く、景気の先行き不透明感による慎重な姿勢が続く状態となっております。

おります。

当社グループにおける当中間期の業績については、売上高455億3千5百万円（前年同期比11.3%増）、売上総利益率の改善等により営業利益11億5千万円（前年同期比87.0%増）、為替差益が生じたことなどにより経常利益12億4千7百万円（前年同期比100.8%増）、投資有価証券の売却による特別利益の計上等により四半期純利益8億6千1百万円（前年同期比179.1%増）となりました。

## 連結業績ハイライト



## 平成23年3月期 連結業績予想

平成23年3月期の通期連結業績予想数値につきまして、産業機器関連の回復が当社の想定以上に推移したことなどを受け、売上・利益ともに4月28日公表の業績予想数値を上回る見通しとなり、9月24日に上方修正をいたしました。その後は概ね想定どおりに推移しております。

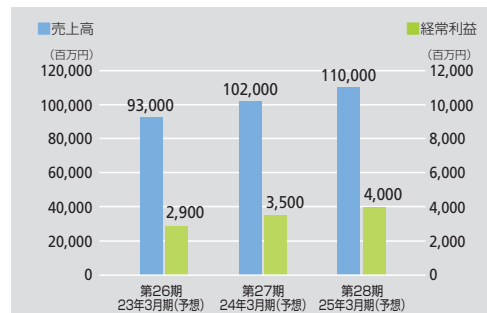
	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A) 4月28日	91,000	2,690	2,600	1,640	15,471.70
今回発表予想(B) 9月24日	93,000	2,870	2,900	1,910	18,018.87
増減額 (B-A)	2,000	180	300	270	-
増減率 (%)	2.2	6.7	11.5	16.5	-

### 3ヶ年計画

事業環境の変化に速やかに対応するため  
ローリング方式の3ヶ年計画を今年度から開始

事業方針として以下を掲げ、連結業績目標の達成を目指しております。

- 半導体及び電子デバイス事業の強化
- コンピュータシステム関連事業の強化
- 新規事業の推進

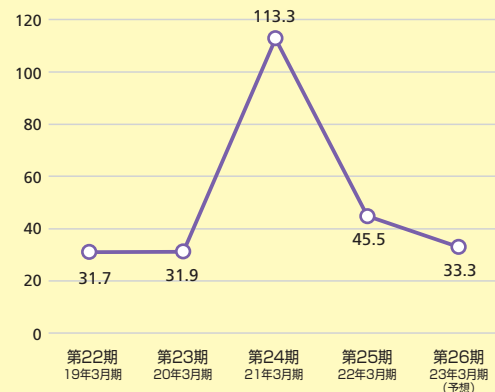


## 株主還元について

当社は、継続的かつ安定的な配当実施を原則としております。また、成長に応じた利益還元につきましても重視し、業績連動型配当として、連結当期純利益に対する配当性向30%を目安とすることを基本方針としております。この方針のもと、中間配当につきましては、3,000円とさせていただきます。期末配当につきましても3,000円を予定しております。

	平成22年3月期		平成23年3月期	
	中間	期末	中間	期末(予想)
1株当たり配当金(円)	2,500	2,500	3,000	3,000
配当性向	45.5%		33.3%(予想)	

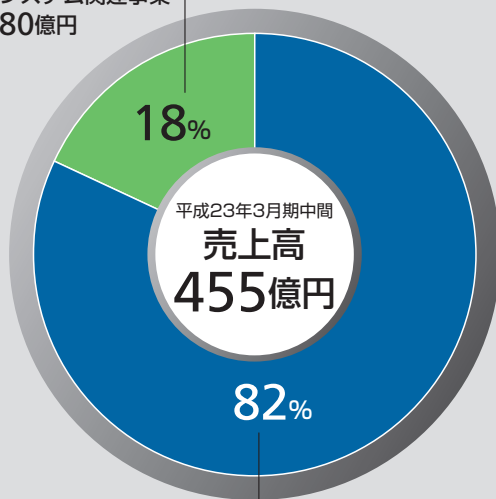
### 配当性向(%)



## 事業紹介

当社グループは、半導体製品、電子部品他の仕入・販売および設計・開発を展開する「半導体及び電子デバイス事業」と、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェアをソリューションで提供する「コンピュータシステム関連事業」を展開しております。

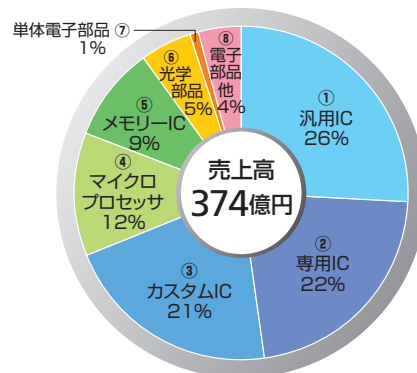
コンピュータ  
システム関連事業  
80億円



半導体及び  
電子デバイス事業  
374億円

## 半導体及び電子デバイス事業

## 品目別売上構成



## ① 汎用 IC

色々な用途に  
使用されるIC



## 主な商品と仕入先

アナログIC (リニアテクノロジー社)  
ロジックIC (テキサス・インスツルメンツ社)

## 主な最終製品

携帯電話、カーナビゲーション、FA機器、  
デジタル家電、携帯電話基地局

## ⑤ メモリー IC

記憶専用のIC



## 主な商品と仕入先

フラッシュメモリ\*3 (富士通エレクトロニクス(株))  
SRAM (IDT社)

## 主な最終製品

デジタル家電、携帯電話、  
通信機器、FA機器

## 当中間期(第2四半期)の業績

民生機器向け半導体製品の売上については、景気対策による需要回復に減速感が出ておりますが、医療機器やFA機器、半導体製造装置等の産業機器関連の需要が好調に推移し、技術サポートが必要な高付加価値の半導体であるアナログICやカスタムICの売上が伸ばしたことから、当中間期における売上高は374億7千5百万円(前年同期比14.7%増)となりました。

## 技術サポート

仕先ごとに専属のエンジニア(FAE)を配置し、お客様への新製品の技術説明や技術的な問い合わせ対応などきめ細かい技術サポートを行っております。



### ② 専用 IC

特定用途向けに作られるIC



#### 主な商品と仕先

画像補正用(ピクセルワークス社)  
画像圧縮用(ピクシシステムズ社)  
通信用(ザールリンク・セミコンダクター社)  
セキュリティ用(インレピアム) **inrevium**

#### 主な最終製品

液晶プロジェクタ、デジタルTV、DVD、  
携帯電話基地局、監視カメラ

### ③ カスタム IC

お客様の仕様に応じて作られるIC



#### 主な商品と仕先

PLD<sup>\*1</sup>(ザイリンクス社)  
ASIC<sup>\*2</sup>(富士通セミコンダクター株)

#### 主な最終製品

デジタル家電、プリンター、  
携帯電話基地局、医療機器

### ④ マイクロプロセッサ

コンピュータの中心となる頭脳として演算・制御機能を持つIC



#### 主な商品と仕先

マイクロプロセッサ(フリースケール・セミコンダクタ社)  
DSP(テキサス・インスツルメンツ社)

#### 主な最終製品

携帯電話基地局、プリンター、医療機器、  
デジタル家電、カーナビゲーション

### ⑥ 光学部品

電気を光に変換して使用する電子部品



#### 主な商品と仕先

LED<sup>\*4</sup>、フォトカブラ<sup>\*5</sup>(アバゴ・テクノロジー社)

#### 主な最終製品

携帯電話、携帯電話基地局、車載機器

### ⑦ 単体電子部品

増幅や整流など単機能部品



#### 主な商品と仕先

ディスクリート(オンセミコンダクター社)

#### 主な最終製品

PC、FA機器

### ⑧ 電子部品他

ボード、電源など



#### 主な商品と仕先

評価ボード(インレピアム) **inrevium**  
電源(コーセル)

#### 主な最終製品

デジタル家電、医療機器、FA機器、通信機器

※1【PLD】プログラム可能な論理素子のカスタムIC。ASICより短期開発が可能。

※2【ASIC】高性能が望めるが、開発期間が長くかかるカスタムIC。

※3【フラッシュメモリ】データを電氣的に保存するメディア。電源が切れても保持が可能。

※4【LED】電流を流すと発光するダイオード。ランプや表示器に使用。

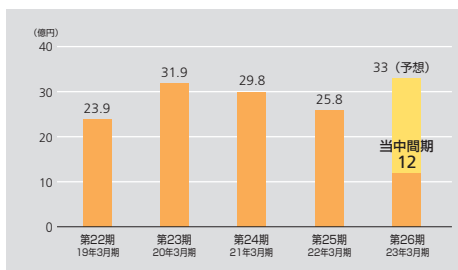
※5【フォトカブラ】電気信号を光に変換して伝送する素子。電氣的な絶縁が利点。

## 半導体及び電子デバイス事業

### 開発ビジネス *inrevium*

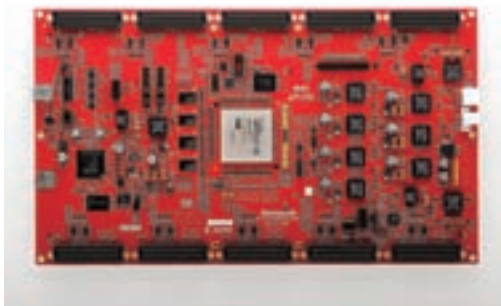
開発ビジネス（インレビウムビジネス）は、お客様の要求に基づきカスタムICやボードの設計を行う設計受託業務（デザインサービス）と市場ニーズに沿ったLSIやボード製品の企画開発を行う自社ブランド商品で構成されております。

#### ■ 開発ビジネス売上高推移



#### ■ 自社ブランド商品開発例

##### FPGA搭載LSI開発支援評価ボード

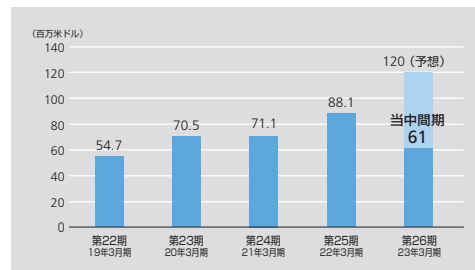


〈主な応用分野〉 3Dテレビ、高画質映像機器

### 海外ビジネス

日系企業を主なお客様として、アジア地域に営業拠点を展開しております。平成17年に東京エレクトロンデバイス香港、平成20年に東京エレクトロンデバイスシンガポールを設立し、上海・大連・深圳にも拠点を構え、多言語対応、良質な物流対応に注力しております。

#### ■ 海外連結子会社売上高推移

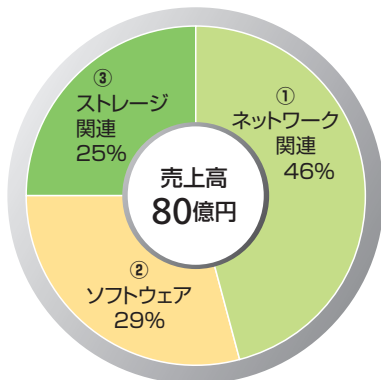


#### ■ 海外営業拠点



## コンピュータシステム関連事業

### 品目別売上構成



### 当中間期(第2四半期)の業績

企業のIT投資に対する慎重な姿勢が続く中、コンピュータ・ネットワーク関連機器の販売は低調に推移いたしました。一方、組み込み機器向けソフトウェアの販売が好調であったことや、コンピュータ・ネットワーク関連機器に係る保守サービスが引き続き堅調に推移したことなどから、当中間期における売上高は80億5千9百万円(前年同期比2.4%減)となりました。

#### ① ネットワーク関連

インターネットの接続負荷の分散、セキュリティ強化



##### 主な仕入先

F5ネットワークス社  
エクストリーム社  
タレス社 他

#### ② ソフトウェア

組み込み機器向けのOSや  
データ管理を行うデータベース



##### 主な仕入先

マイクロソフト社  
オラクル社 他

#### ③ ストレージ関連

大容量データの記憶、  
圧縮をネットワーク上で実現



##### 主な仕入先

ブロード社  
エミュレックス社  
クアンタム社 他

### インターネット環境を効率化するデータセンターへの導入を推進

データセンターは、インターネット環境に必要なサーバなどの通信機器を集約して設置、運用する施設です。

当社では、大容量データを高圧縮処理するストレージ機器や安定的な接続を可能にするネットワーク機器等をデータセンター向けに提供しております。



データセンター

## 連結財務諸表

## 中間(第2四半期)連結貸借対照表

資産の部	前第2四半期末	第2四半期末	前 期
	(平成21年9月30日現在)	(平成22年9月30日現在)	(平成22年3月31日現在)
	千円	千円	千円
流動資産	39,515,340	43,940,625	41,136,668
現金及び預金	1,151,796	1,386,775	1,621,262
受取手形及び売掛金	19,268,118	20,528,250	20,890,706
商品及び製品	16,349,644	18,834,664	15,508,551
仕掛品	184,806	114,476	128,158
その他	2,562,814	3,220,181	2,989,992
貸倒引当金	△ 1,840	△ 143,722	△ 2,002
固定資産	4,540,398	4,410,827	4,512,349
有形固定資産	1,239,401	1,121,851	1,121,766
無形固定資産	536,230	438,548	464,922
投資その他の資産	2,764,765	2,850,426	2,925,660
資産合計	44,055,738	48,351,453	45,649,018

## ■ 資産

総資産は483億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億2百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少した一方、商品及び製品が増加したことによります。

## ■ 負債

負債総額は258億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億7千5百万円の増加となりました。これは主に、未払法人税等が減少した一方、買掛金、短期借入金が増加したことによります。

負債の部	前第2四半期末	第2四半期末	前 期
	(平成21年9月30日現在)	(平成22年9月30日現在)	(平成22年3月31日現在)
	千円	千円	千円
流動負債	17,664,809	20,387,580	18,538,665
買掛金	7,658,160	7,956,431	7,255,698
短期借入金	5,474,748	6,608,449	5,105,824
未払法人税等	277,241	501,296	1,132,170
賞与引当金	420,542	736,958	856,855
役員賞与引当金	—	21,075	26,158
その他	3,834,116	4,563,369	4,161,957
固定負債	4,944,386	5,425,603	5,198,928
退職給付引当金	4,521,739	4,919,327	4,715,170
役員退職慰労引当金	87,475	115,048	102,523
その他	335,172	391,228	381,234
負債合計	22,609,196	25,813,184	23,737,593
<b>純資産の部</b>			
株主資本	21,451,852	22,640,901	22,044,207
資本金	2,495,750	2,495,750	2,495,750
資本剰余金	5,645,240	5,645,240	5,645,240
利益剰余金	13,310,862	14,499,910	13,903,216
評価・換算差額等	△ 5,309	△ 102,633	△ 132,781
その他有価証券評価差額金	△ 1,182	—	—
繰延ヘッジ損益	79,519	22,892	△ 67,167
為替換算調整勘定	△ 83,647	△ 125,525	△ 65,614
純資産合計	21,446,542	22,538,268	21,911,425
負債及び純資産合計	44,055,738	48,351,453	45,649,018

## ■ 純資産

純資産総額は225億3千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億2千6百万円の増加となりました。自己資本比率は46.6%となり前連結会計年度末に比べ1.4ポイント低下いたしました。



## 中間(第2四半期)連結損益計算書

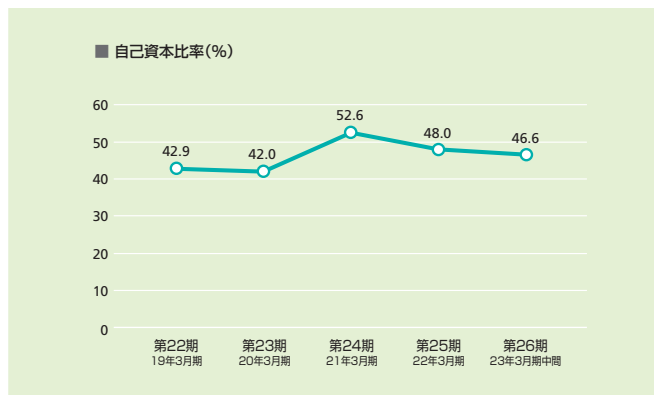
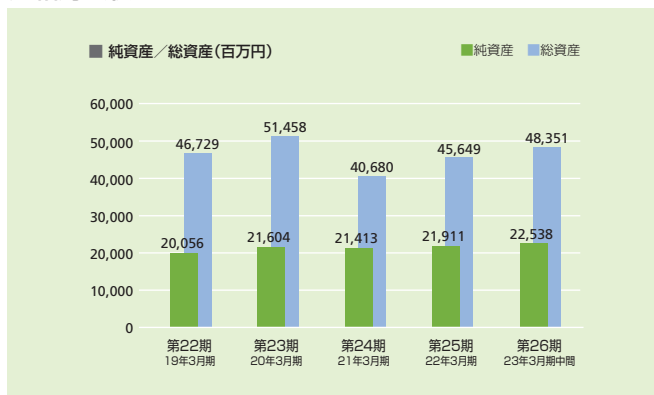
科 目	前第2四半期累計	第2四半期累計
	(平成21年4月1日から 平成21年9月30日まで)	(平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで)
	千円	千円
売上高	40,923,706	45,535,731
売上原価	34,630,680	37,808,915
売上総利益	6,293,026	7,726,815
販売費及び一般管理費	5,677,617	6,575,936
営業利益	615,409	1,150,878
営業外収益	47,194	128,890
営業外費用	41,666	32,761
経常利益	620,937	1,247,007
特別利益	-	116,343
特別損失	73,287	52,114
税金等調整前四半期純利益	547,649	1,311,235
法人税等	238,913	449,541
四半期純利益	308,736	861,694

## 中間(第2四半期)連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前第2四半期累計	第2四半期累計
	(平成21年4月1日から 平成21年9月30日まで)	(平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで)
	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,364,032	△ 1,316,124
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,936	△ 145,755
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,336,929	1,247,074
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 5,766	△ 19,682
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 93,806	△ 234,487
現金及び現金同等物の期首残高	1,245,602	1,621,262
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,151,796	1,386,775

(注) 連結財務諸表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結財政状態



## 株式情報 (平成22年9月30日現在)

### 株式の状況

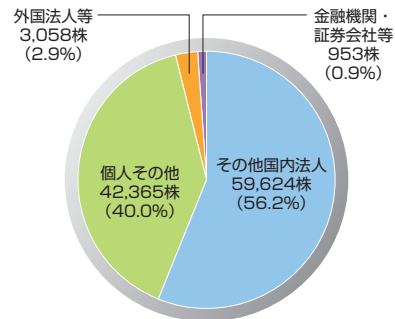
発行可能株式総数	256,000 株
発行済株式の総数	106,000 株
株主数	5,565 名

### 大株主

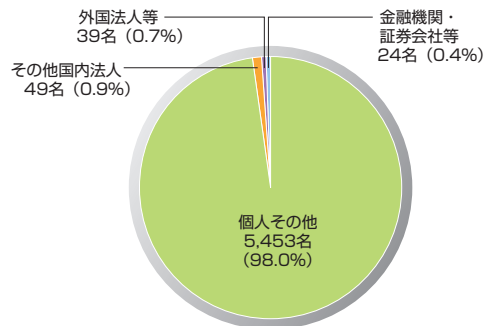
株主名	持株数	出資比率
	株	%
東京エレクトロン株式会社	58,753	55.4
東京エレクトロンデバイス社員持株会	4,386	4.1
ノーザン トラスト カンパニー エイブイ エフシー リ ノーザン トラスト ガン ジー ノン トリーディー クライアンツ	1,003	0.9
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカUNT ジェイビーア ールディ アイエスジー エフイーエイシー	882	0.8
岩崎 泰次	440	0.4

### 株式分布状況

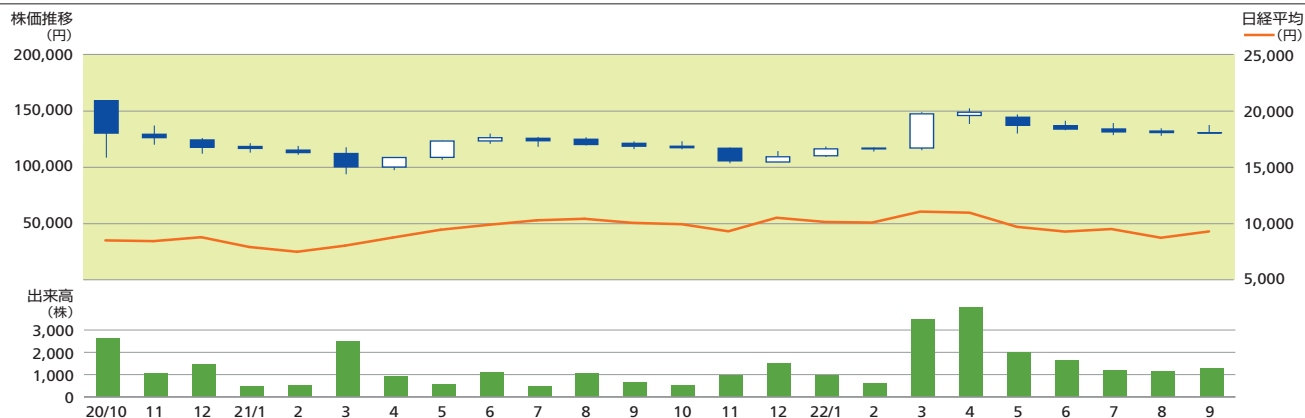
#### 所有者別株式数



#### 所有者別株主数



### 株価と出来高



## 会社の概要 (平成22年9月30日現在)

### 会社概要

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立	昭和61年3月3日
資本金	2,495,750,000円
従業員数	879名(連結)
本社	神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア

### 拠点網 (平成22年10月1日現在)

#### 本社

#### 本社営業部

北関東支社 (埼玉県・さいたま市)

大阪支社

名古屋支社

仙台営業所 水戸営業所

立川営業所 長岡営業所

松本営業所 三島営業所

浜松営業所 京都営業所

姫路営業所 広島営業所

福岡営業所

本社第二営業部4グループ (神奈川県・厚木市)

北関東支社郡山サテライト (福島県・郡山市)

北関東支社営業第4グループ (栃木県・宇都宮市)

新宿オフィス

大阪オフィス

つくばサテライト

エンジニアリングセンター (神奈川県・横浜市)

上海華桑電子有限公司 (通称: 東京エレクトロンデバイス上海)

香港華桑電子有限公司 (通称: 東京エレクトロンデバイス香港)

無錫華桑電子科技有限公司 (通称: 東京エレクトロンデバイス無錫)

Tokyo Electron Device Singapore Pte. Ltd. (通称: 東京エレクトロンデバイスシンガポール)

パネトロン株式会社

### 役員等

#### 取締役

代表取締役会長	砂川俊昭
代表取締役社長	栗木康幸
取締役	久我宣之
取締役	木村勉
取締役	天野勝之
取締役	徳重敦之
取締役	東哲郎
取締役	中村隆
取締役	岩田義文

#### 監査役

常勤監査役	浅野升徳
監査役	田中健生
監査役	林田謙一郎
監査役	川勝正昭

- (注) 1. 岩田義文氏は、社外取締役であります。  
2. 林田謙一郎氏および川勝正昭氏は社外監査役であります。

#### 執行役員

砂川俊昭
栗木康幸
久我宣之
木村勉
天野勝之
徳重敦之
穴倉弘明
大崎正之
八幡浩司
武井弘
黒田修治
山田信二
林英樹

## 個人投資家様向けIR活動

当社は、新聞社や証券会社などが主催するIRフェアや個人投資家説明会に参加しております。  
また、当社ホームページ内に個人投資家様向け専用サイトをご用意し、事業内容、業績情報などの配信に努めております。



- 日経IRフェア2010  
(平成22年9月3日～4日 東京ビッグサイト)



### 主なコンテンツ

トップメッセージ  
IR最新情報  
決算・財務情報  
会社情報  
株式情報  
IR資料室  
IRスケジュール  
個人投資家の皆様へ など

- 当社IRサイト：  
<http://www.teldevice.co.jp/ir/>

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主確定日	期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日
株主名簿管理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
(郵便物送付先) 電話照会先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社証券代行部 証券代行事務センター 0120-78-2031 (フリーダイヤル)
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店
公告の方法	電子公告
上場金融商品取引所	東京証券取引所 市場第二部 (証券コード 2760)

### ● 「配当金計算書」について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。

なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、本年より配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただきます。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。



半導体及び電子デバイス事業にて認証取得

この報告書は、適切に管理された森林から生まれた「FSC™ 認証紙」を使用し、VOC（揮発性有機化合物）の発生を抑えた「植物性インキ」を使用しています。